



TS944AIN

Onderdeel nummer	TS944AIN	RoHS-status	
Fabrikant / Merk	STMicroelectronics	Voorraad conditie	5026 pcs stock
Product beschrijving	IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP	Vershipen van	Hong Kong
Datasheets	TS941x(A,B).pdf	Zending manier	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Krijg een offerte

Klik op "Koop een offerte" en vul alle vereiste velden in. We zullen binnen 24 uur op uw verzoek reageren via e-mail. Als u problemen tegenkomt, laat dan een bericht achter of e-mail ons op info@global-ic.hk, en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

[KRIJG EEN OFFERTE](#)

Afbeelding kan representatie zijn. Zie specificaties voor productdetails.

-specificaties van TS944AIN

Spanning - Leveringsspanne (min)	2.5 V	Spanning - Supply Span (Max)	10 V
Voltage - Input Offset	5 mV	Leverancier Device Pakket	14-DIP
slew Rate	0.0045V/μs	Serie	-
Verpakking / doos	14-DIP (0.300", 7.62mm)	Pakket	Tube
Output Type	Rail-to-Rail	Temperatuur	-40°C ~ 85°C
Aantal circuits	4	montage Type	Through Hole
Gain Bandwidth Product	10 kHz	Current - Supply	1.2μA (x4 Channels)
Current - Output / Channel	5 mA	Current - Input Bias	1 pA
Base Productnummer	TS944	Amplifier Type	General Purpose

Gerelateerd nieuws



Infineon probeert recyclebare PCB's voor demo- en evalboards
2023/07/28

Embedded World 2023: Krijg de volledige wekelijkse gids voor elektronica
2023/03/17

Toshiba voegt vier-pins SIC MOSFET toe om verliezen te verminderen
2023/08/31

Energieoogst Socs verlengen het IoT -aanbod van Mouser Electronics
2023/07/4

Rekbare PCB's in Smart Cardiac Monitor, en meer
2023/08/16

ROHM integreert stuurprogramma met GAN Hemt om poortspannings ellende te verwijderen
2023/08/31

Samengestelde halfgeleider katapult breidt zich uit naar Bristol, Glasgow en Durham
2023/07/20

Embedded World: Video Interview - Longsys on R&D, Design and Sales of Storage
2023/03/27

Supercondensatorbanken voor energieopslag
2023/08/16

CSL's nieuwgebouw Derbyshire HQ is zes keer groter
2023/08/3

Automotive Hall Current Sensor is 1% gedurende het leven en omvat MCU
2023/09/12

Gesponsorde inhoud: verhuizen naar succes: convergerende OT en IT met Future Proof Industrial Network Infra
2023/09/18